

## ВОЛЬТ-ФАРАДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА $m-s$ -СТРУКТУР С ИЗОТИПНЫМ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ

Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Панахов М. М.

Теоретически установлено наличие ступенчатой особенности на вольт-фарадных характеристиках (ВФХ) диода Шоттки с изотипным гетеропереходом, имеющим узкозонную область под металлом и широкозонную в толще. Если толщина узкозонной прослойки превосходит равновесную толщину области пространственных зарядов (ОПЗ) под металлом не более чем в 2 раза, то при наложении обратного смещения граница ОПЗ проходит через гетеропереход. С этим и связаны особенности на ВФХ. По этим особенностям можно определить величину разрыва зоны на гетеропереходе и толщину узкозонной прослойки. Повышение температуры сглаживает особенности на ВФХ.

*Введение.* В настоящей работе рассматривается диод Шоттки, у которого металлический контакт нанесен на тонкий узкозонный слой, находящийся на микрозонной подложке. Изотипный гетеропереход, разделяющий широкозонную подложку и узкозонную прослойку, считается резким и идеальным (в смысле отсутствия на нем поверхностных состояний). Такие структуры могут использоваться в качестве селективных фотоприемников и выпрямителей. Нас здесь они интересуют с другой точки зрения, а именно на предмет экспериментального измерения величины разрыва в зоне проводимости (или в валентной зоне) на гетеропереходе с помощью вольт-фарадных характеристик (ВФХ). В работе [1] нами было теоретически показано, что существует такая возможность для  $m-s$ -гетероструктур с широкозонной прослойкой. Она обусловлена возникновением особенности типа ступени на ВФХ. Ширина ступени по шкале напряжений связана с величиной разрыва зоны на гетеропереходе и существенно превосходит этот разрыв. ВФХ таких структур рассматривались ранее в [2], однако там не обращалось внимание на возможность возникновения ступенчатых особенностей на ВФХ. В работе [3] было показано, что с повышением температуры происходит размытие ступени. Теория, учитывающая это размытие, оказывается достаточно громоздкой. Рассматриваемые здесь  $m-s$ -структуры с узкозонной прослойкой, с теоретической точки зрения, представляют более простой объект, поскольку пространственный ход потенциала внутри прослойки при любых внешних смещениях оказывается монотонным. В структурах же с широкозонной прослойкой потенциал внутри прослойки при малых смещениях имеет минимум, а при больших смещениях становится монотонным. Кроме таких чисто теоретических преимуществ, технология изготовления гетероструктур с узкозонным поверхностным слоем может оказаться более предпочтительной. Поэтому расширение знаний о ВФХ гетероструктур с узкозонной прослойкой представляется актуальным.

### 1. Основные результаты работы

Энергетические диаграммы  $m-s$ -гетероструктур  $n$ -типа в термодинамическом равновесии схематически изображены на рис. 1. Следует обратить внимание на то, что в прослойке имеется квазинейтральная область, так что прослойка должна быть достаточно толстой. Кроме того, требуется, чтобы при наложении запорного смещения граница области пространственного заряда (ОПЗ) пере-

секала гетеропереход. Для этого прослойка не должна быть и слишком толстой, так как в противном случае может наступить лавинный пробой, прежде чем ОПЗ пересечет гетеропереход и выйдет в толщу. Поэтому существует некоторый оптимальный интервал значений толщины прослойки, который зависит от концентрации легирующей примеси, величины разрыва зон на гетеропереходе и напряжения пробоя. Если толщина прослойки попадает в этот интервал, то на ВФХ  $m-s$ -гетероструктуры может наблюдаться ступенчатая особенность, вид которой схематически показан на рис. 2. Здесь ВФХ структуры с узкозонной прослойкой отмечена номером 1, а с широкозонной — номером 2. На ней присутствует ступенчатый выступ, тогда как на ВФХ  $m-s$ -структур с узкозонной прослойкой, изучаемых в этой работе, имеется ступенчатая впадина. В обоих случаях имеется горизон-

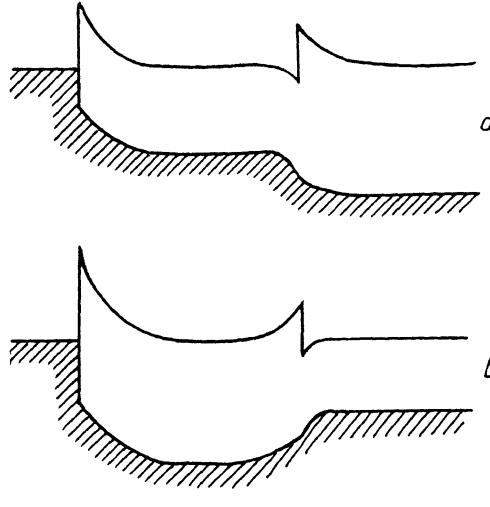


Рис. 1. Зонная диаграмма структуры металл—полупроводник с гетеропереходом.  
а — с узкозонной прослойкой под металлом, б — с широкозонной прослойкой.

Рис. 1. Зонная диаграмма структуры металл—полупроводник с гетеропереходом.

а — с узкозонной прослойкой под металлом, б — с широкозонной прослойкой.

тальный участок, который мы назвали в [1] «моттовским» плато. Величина емкости на плато  $C_a$  определяется только толщиной прослойки:

$$C_a = \epsilon_1 S / 4\pi a, \quad (1)$$

где  $\epsilon_1$  и  $a$  — диэлектрическая проницаемость и толщина прослойки,  $S$  — площадь структуры. В приближении истощенного слоя для ширины плато  $\Delta V$  можно получить следующее выражение:

$$\begin{aligned} \Delta V_{ys} &= 2\sqrt{V_a \Delta \psi / \alpha}; \\ \Delta V_{ws} &= 2\sqrt{V_a \Delta \phi}, \end{aligned} \quad (2)$$

где  $\Delta V_{ys}$  и  $\Delta V_{ws}$  — ширины моттовского плато по шкале напряжений для структур с узкозонной и широкозонной прослойкой,

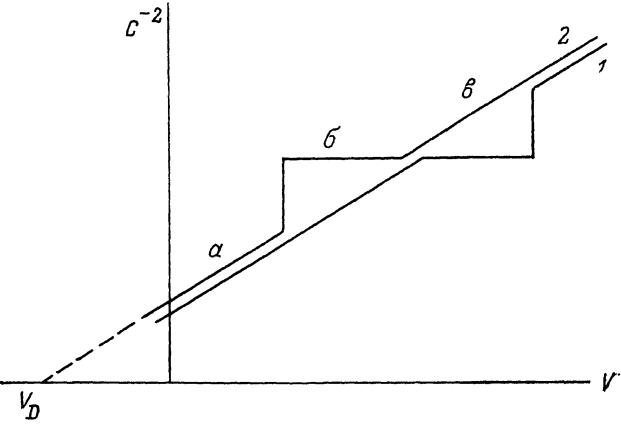


Рис. 2. Схематические изображения ВФХ  $m-s$ -гетероструктур.

1 — для структуры с узкозонной прослойкой, 2 — с широкозонной.

$$V_a = 2\pi e N_1 a^2 / \epsilon_1 \quad (3)$$

— характерный параметр напряжения. Для  $m-s$ -гетероструктуры с узкозонной прослойкой, являющейся предметом данной статьи, левая граница плато  $V = V_1$  определяется условием

$$V_1 + V_D = V_a, \quad (4)$$

где

$$V_D = \Phi_{B1} - (kT/e) \ln (N_{c1}/N_1) \quad (5)$$

— диффузионный потенциал со стороны полупроводника,  $\Phi_{B1}$  — высота потенциального барьера со стороны металла,  $N_1$  — концентрация доноров в про-

слойке,  $N_{c1}$  — эффективная плотность состояний в прослойке. Абсолютная величина разрыва потенциала  $\Delta\phi$  на гетеропереходе

$$\Delta\phi = \Delta E_c \pm (kT/e) \ln (N_2 N_{c1} / N_1 N_{c2}). \quad (6)$$

Здесь  $\Delta E_c$  — разрыв зоны проводимости (рассматривается для определенности полупроводник  $n$ -типа),  $N_2$  — концентрация доноров,  $N_{c2}$  — эффективная плотность состояний в толще структуры. Знаки «+» и «-» в (6) относятся к структурам с узкозонной и широкозонной прослойками. Анализ формулы (6) показывает, что разрыв потенциала  $\Delta\phi$  оказывается больше разрыва зоны  $\Delta E_c$ , если узкозонная сторона изотипного гетероперехода легирована слабее, чем широкозонная. Параметр асимметрии легирования  $\alpha$ , входящий в (2) для  $\Delta V_{yz}$  имеет вид

$$\alpha = \epsilon_1 N_1 / \epsilon_2 N_2, \quad (7)$$

где  $\epsilon_2$  — диэлектрическая проницаемость широкозонной толщи. Рис. 2 относится к случаю  $\alpha=1$ , когда  $\epsilon_1 N_1 = \epsilon_2 N_2$ . Такой случай мы в дальнейшем будем называть симметричным легированием. При этом наклоны ВФХ на участках  $a$  и  $b$  совпадают, поскольку наклон определяется произведением  $\epsilon N$ . Участок  $a$  соответствует перемещению границы приконтактной ОПЗ внутри прослойки

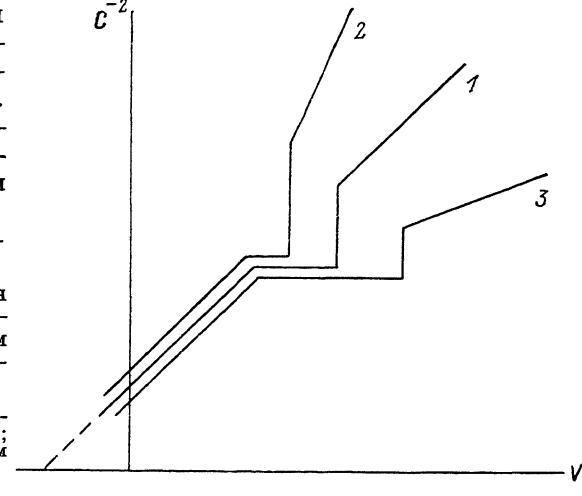


Рис. 3. Схематические изображения ВФХ  $m-s$ -гетероструктуры с узкозонной прослойкой при различном легировании широкозонной подложки.

1 — симметричное легирование; 2 — подложка легирована слабее, чем прослойка; 3 — подложка легирована сильнее, чем прослойка.

( $V < V_1$ ), а участок  $b$  — в широкозонной толще ( $V > V_1 + \Delta V$ ). Для участка  $b$  характерно полное истощение прослойки и какой-то части толщи. Если параметр  $\alpha \neq 1$ , то наклоны участков  $a$  и  $b$  уже не совпадают. Кроме того, для  $m-s$ -структур с узкозонной прослойкой изменяется ширина плато  $\Delta V$  на ВФХ. Это иллюстрируется зависимостями на рис. 3. Зависимость 1 относится к случаю  $\alpha=1$ . Если подложка легирована слабее, чем прослойка ( $\alpha > 1$ , кривая 2), то плато укорачивается, а скачок емкости оказывается плохо отличимым от участка  $b$  на ВФХ. Если же, наоборот, подложка легирована сильнее, чем прослойка ( $\alpha < 1$ , кривая 3), то скачок емкости оказывается очень малым, а плато сливаются с участком  $b$  на ВФХ. Таким образом, ступенчатая особенность на ВФХ, связанная с гетеропереходом, наиболее четко прорисовывается тогда, когда легирование близко к симметричному. Обратим внимание также на то, что участок и уровень плато на рис. 3 у всех трех зависимостей совпадают. Они нарисованы несколько раздвинутыми лишь для удобства. Ступенчатые ВФХ, изображенные на рис. 2 и 3, получены в приближении истощенного слоя. Соответствующие аналитические выражения будут приведены в следующем разделе. Это приближение справедливо лишь при очень низких температурах. Для структур на основе систем  $Ga_xAl_{1-x}As$  такие характеристики будут получаться при температурах ниже азотной. С повышением температуры ступенчатая особенность характеристики слаживается. На рис. 4 представлены ВФХ для  $m-s$ -структур с узкозонной прослойкой при трех температурах. Штрихпунктирная зависимость 1 рассчитана в приближении истощенного слоя и соответствует случаю  $T=0$ . Сплошная кривая 2 и штриховая кривая 3 относятся к случаю  $T=77$  и  $300$  К. Эти кривые рассчитаны по точной теории, которая излагается

в последующих разделах. Из рисунка видно, что с повышением температуры действительно происходит существенное размытие ступенчатой особенности на ВФХ. Поэтому для их экспериментального наблюдения необходимо измерять ВФХ при азотной или более низкой температурах. На рис. 4 построена зависимость приведенной характеристики  $\chi(V)$ , которая имеет размерность напряжения:

$$\chi(V) = (e\epsilon_1 N_1 S^2 / 8\pi) C^{-2}(V). \quad (8)$$

На участке  $a$  она имеет простой вид

$$\chi(V) = V + V_D, \quad (V < V_1). \quad (9)$$

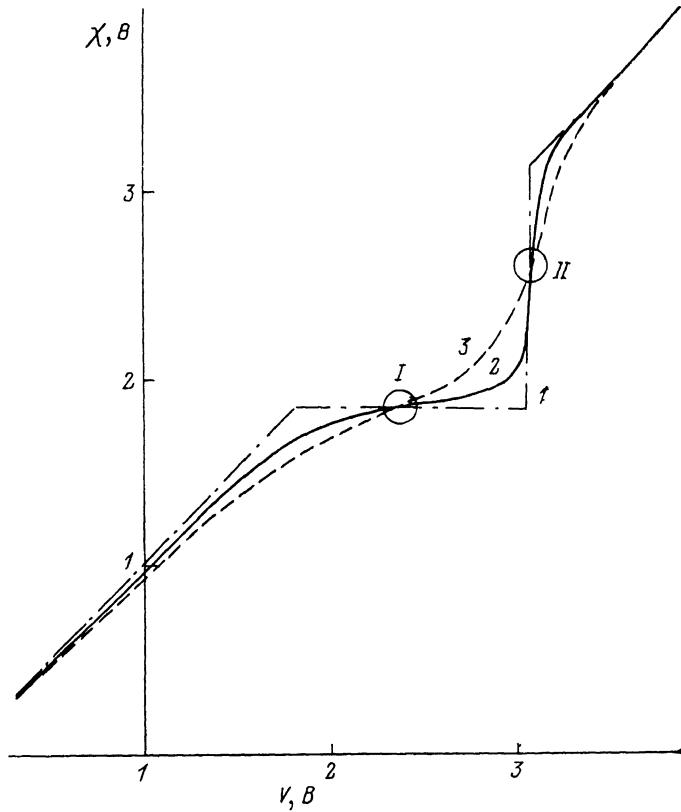


Рис. 4. ВФХ  $m-s$ -гетероструктуры с узкозонной прослойкой GaAs при различных температурах.

$T, K: 1 = 0, 2 = 77, 3 = 300$ . Изотипный гетеропереход легирован симметрично ( $\alpha = 1$ ). Толщина прослойки равна 12 дебаевским радиусам при  $T = 300$  К ( $A = 12$ ). Величина разрыва на гетеропереходе составляет  $\Delta E_c = 0.21$  эВ ( $\beta_0 = 7$ ). Концентрация доноров  $N_1$  (в  $\text{см}^{-3}$ ) и толщина подложки  $a$  (в мкм) связаны соотношением  $N_1 a^2 = 2.7 \cdot 10^{16}$ .

На участке  $b$  моттовского плато

$$\chi(V) = V_a, \quad (V_1 < V < V_1 + \Delta V_{yb}), \quad (10)$$

где  $\Delta V_{yb}$  определяется формулой (2). На участке  $c$ , где  $V > V_1 + \Delta V_{yb}$ ,

$$\chi(V) = \alpha [V + V_D + \Delta \phi - V_a (1 - 1/\alpha)]. \quad (11)$$

Наклон функции  $\chi(V)$  здесь равен  $\alpha$ .

Наконец, подробно остановимся на результатах точной теории, разработанной нами в настоящей статье, с помощью которой были вычислены характеристики 2 и 3 (при  $T = 77$  и 300 К соответственно) на рис. 4. Согласно этой теории,

$$\chi(V) = \frac{kT}{4e} \left[ \frac{\partial}{\partial v} \sqrt{f(y_0)} \right]^{-2}, \quad (12)$$

где

$$f(y) = y - (1 - e^{-y}) e^{-u} + (\beta + u)/\alpha. \quad (13)$$

Величина  $y_0$  есть безразмерная функция потенциала металлического контакта:

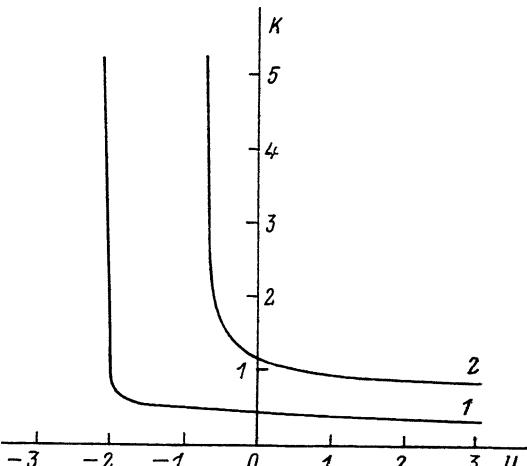
$$y_0 = v - u, \quad v = (V + V_D) e/kT, \quad (14)$$

а величина  $u$  — безразмерное значение потенциала в провале в непосредственной близости слева от гетерограницы. Эта величина также зависит от внешнего смещения  $V$ . Эта зависимость является обратной функцией уравнения

$$\begin{aligned} v &= v + e^{-u} - \frac{\beta + u}{\alpha} + \frac{1}{2} [A + \\ &+ \sqrt{2(\beta + u)/\alpha} - K(u) e^{-u}/\sqrt{2}]^2, \quad (15) \end{aligned}$$

Рис. 5. Зависимость приведенной толщины квазинейтральной области  $K$  от безразмерного потенциала провала на гетеропереходе  $U$  для разных асимметрий легирования  $\alpha$  изотипного гетероперехода.

$\alpha: 1 - 1, 2 - 10.$



где  $\beta$  — безразмерный параметр, характеризующий разрыв потенциала на гетерогранице:

$$\beta = \beta_0 - \ln \alpha, \quad \beta_0 = \Delta E_c e/kT + \ln (\epsilon_1 N_{c1}/\epsilon_2 N_{c2}) + 1, \quad (16)$$

$A$  — безразмерная толщина прослойки:

$$A = x_1 a, \quad x_1^2 = 4\pi e^2 N_1 / \epsilon_1 kT. \quad (17)$$

Функция  $K(u)$ , входящая в правую часть (15), задается интегралом:

$$K(u) = \int_0^\infty [e^{-y}/\sqrt{f(y)}] dy. \quad (18)$$

Здесь  $f(y)$  определяется формулой (13). Таким образом, правая часть уравнения (15) зависит только от  $u$ , что позволяет легко найти  $v$  как функции  $u$ . Из этого же уравнения можно определить и производную  $du/dv$ . Тогда выражение (12) можно написать в более удобной форме:

$$\chi = \frac{kT}{e} \frac{v - u - e^{-u} + (\beta + u)/\alpha}{[1 - (1 - e^{-u} - 1/\chi) (du/dv)]^2}. \quad (19)$$

По формулам (19), (15) и были вычислены кривые 2 и 3 на рис. 4. При этом необходимо найти величину  $K(u)$ , которая дается интегралом (18). Следует иметь в виду, что эта функция обладает сингулярностью при некотором отрицательном значении  $u$ :

$$u = -v_0, \quad v_0 > 0. \quad (20)$$

При  $u < -v_0$  функция  $K(u)$  вообще не существует, так как она расходится логарифмически при  $u \rightarrow -v_0$ . На рис. 5 представлены зависимости  $K(u)$  для двух значений параметра асимметрии  $\alpha=1$  (кривая 1) и  $\alpha=10$  (кривая 2) при значении параметра разрыва зоны  $\beta_0=7$ . Эти кривые имеют логарифмическую особенность в точке  $u=-v_0$ , определяемой из трансцендентного уравнения

$$v_0 + 1 - e^{v_0} + (\beta - v_0)/\alpha = 0. \quad (21)$$

Поэтому численный расчет функции  $K(u)$  непременно требует решить уравнение (21), чтобы определить точку сингулярности. Так, например, оно дает значение  $u_0=2.07944$  при  $\alpha=1$  и  $u_0=0.77231$  при  $\alpha=10$ .

## 2. Методика определения параметров $m-s$ -гетероструктуры по особенностям ВФХ

Идеальная ступенчатая особенность на ВФХ в принципе дает весьма конструктивную возможность определения параметров  $m-s$ -гетероструктуры. По наклонам на участках  $a$  и  $b$  можно определить концентрации легирующих примесей  $N_1$  и  $N_2$  в узкозонной и широкозонной областях, а по экстраполированному напряжению отсечки — диффузионный потенциал  $V_d$ . Значение емкости на плато позволяет определить толщину  $a$  узкозонной прослойки по формуле (1). Этую же величину можно проконтролировать по другой характерной точке, а именно по напряжению левого края плато  $V_a$  согласно формуле (3). Наконец, по ширине плато  $\Delta V$  можно определить величину разрыва  $\Delta\phi$  согласно выражению (2). К сожалению, ни при азотной, а тем более при комнатной температуре идеальная ступенчатая особенность на ВФХ не реализуется, как это видно из рис. 4. Уменьшение температуры до азотной и ниже может привести к дополнительным осложнениям, которые связаны с вымораживанием носителей в твердом растворе за счет влияния  $Dx$ -центров. В теории мы предполагаем концентрацию носителей не зависящей от температуры. Однако, как показывает внимательный анализ сглаженных ВФХ, полученных для конечных температур путем численных расчетов, возможности для определения параметров  $m-s$ -гетероструктуры все же остаются. В качестве характерных точек теперь уже выступают точки перегиба на ВФХ. Таких точек две; на рис. 4 они обведены кружками и отмечены римскими цифрами I и II (первая и вторая точки перегиба). Их отличительные свойства состоят в следующем: ордината первой точки перегиба с большой точностью совпадает с уровнем плато; у второй же точки перегиба абсцисса с хорошей точностью совпадает с правой границей плато  $V_2$ . Этих двух условий достаточно для определения двух величин: толщины узкозонной прослойки  $a$  и разрыва потенциала  $\Delta\phi$ . Толщина прослойки  $a$  находится по известной формуле (1) емкости структуры в точке первого перегиба. Уровни легирования  $N_1$  и  $N_2$ , а также диффузионный потенциал  $V_d$  находятся по линейным участкам  $a$  и  $b$  на ВФХ. После этого можно рассчитать параметр напряжения  $V_a$  по формуле (3). Определив  $V_d$  и  $V_a$ , мы находим положение левой границы плато идеальной ступенчатой ВФХ по формуле (4). Напряжение правой границы плато  $V_2$  определяется абсциссой второй точки перегиба. После этого ширина плато  $\Delta V=V_2-V_1$  позволяет вычислить разрыв потенциала  $\Delta\phi$  по формуле (2) и найти разрыв зоны  $\Delta E_c$  на гетеропереходе по формуле (6).

## 3. Концентрационно зависящий потенциал электронов в полупроводнике

Если состав твердого раствора меняется вдоль оси  $x$ , то электронное средство и положение края зоны  $E_c(x)$ , а также плотность состояний в зоне  $N_c(x)$  будут функциями координаты  $x$ . В этом направлении может изменяться также и концентрация мелких легирующих примесей  $N(x)$ . В полупроводниках  $n$ -типа  $N(x)$  будет концентрацией мелких доноров. В задачах о гетероструктуре обычно используют в качестве потенциала энергии электрона на дне зоны проводимости:

$$U_c(x) = -\varphi(x) + E_c(x), \quad (22)$$

где  $\varphi(x)$  — обычный электростатический потенциал,  $E_c(x)$  — положение края зоны проводимости при  $\varphi=\text{const}$ , которое определяется изменением состава электронного средства. В случае резкого гетероперехода  $\varphi(x)$  — непрерывная функция, а  $E_c(x)$  терпит разрыв на гетерогранице. Если гетеропереход плавный и концентрация доноров  $N(x)$  тоже изменяется плавно, то наиболее удобной

функцией оказывается не  $U_c(x)$ , а концентрационно зависящий потенциал  $\psi(x)$ , который мы определили следующим образом:

$$\psi(x) = U_c(x) + (kT/e) \ln [N(x)/N_c(x)] - \mu, \quad (23)$$

где  $\mu$  — химический потенциал электронов в однородной толще при

$$\mu = (kT/e) \ln (N_2/N_{c2}). \quad (24)$$

Здесь  $N_2 = N_2(x) |_{x \rightarrow \infty}$ ,  $N_{c2} = N_{c2}(x) |_{x \rightarrow \infty}$ . Мы будем считать электроны невырожденными. Тогда их концентрация описывается распределением Больцмана:

$$n(x) = N_c(x) \exp \{e[\mu - U_c(x)]/kT\}. \quad (25)$$

Удобство потенциала  $\psi(x)$ , определенного нами согласно (23), состоит в том, что концентрация электронов (25) записывается в наиболее простом виде

$$n(x) = N(x) \exp [-e\psi(x)/kT]. \quad (26)$$

Разрыв потенциала  $\Delta\psi$  на резком гетеропереходе оказывается тогда отличным от разрыва зоны  $\Delta E_c$  и связан с ним соотношением (6). Отметим, что из ВФХ барьерных структур с гетеропереходом непосредственно определяется именно разрыв  $\Delta\psi$ , а вовсе не разрыв в зоне ( $\Delta E_c$ ). Поэтому введение потенциала  $\psi$  вместо  $U_c$  дает не только формальное удобство, но также отражает и физическую сущность задачи.

Уравнение для потенциала  $\psi(x)$  вытекает из уравнения Пуассона для потенциала  $\phi(x)$  и определяется (22) и (23):

$$\frac{d}{dx} \left[ \epsilon(x) \frac{d\psi}{dx} \right] = 4\pi(\rho + \rho_f), \quad (27)$$

где  $\epsilon(x)$  — диэлектрическая проницаемость варизонного полупроводника,  $\rho$  — обычная плотность электрического заряда:

$$\rho = eN(x)[1 - \exp(-e\psi/kT)]; \quad (28)$$

$\rho_f$  — плотность «фиктивного» заряда, возникающая из-за отличия между потенциалами  $\phi$  и  $\psi$ :

$$\rho_f = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{dx} \left\{ \epsilon(x) \frac{d}{dx} \left[ \epsilon_c(x) + \frac{kT}{e} \ln \frac{N(x)}{N_c(x)} \right] \right\}. \quad (29)$$

Одно из граничных условий для потенциала  $\psi$  связано с уравнением (26):

$$\psi(x) |_{x \rightarrow \infty} = 0. \quad (30)$$

При  $x=0$  на границе раздела полупроводника и металла обычная физическая модель границы дает условие для положения края зоны:

$$U_c(x) |_{x=0} = \Phi_B + \mu_s, \quad (31)$$

где  $\mu_s$  — химический потенциал электронов металла, который привязан к уровню поверхностных состояний полупроводника. В термодинамическом равновесии уровень  $\mu_s$  совпадает с положением уровня Ферми электронов  $\mu$  в толще полупроводника. При включении внешнего электрического смещения ( $V > 0$  для запорного напряжения) квазиуровень электронов металла  $\mu_s$  окажется выше, чем квазиуровень Ферми электронов  $\mu$  в толще полупроводника:

$$\mu_s = \mu + V. \quad (32)$$

Мы предполагаем, что квазиуровень Ферми  $\mu$  не зависит от координаты  $x$  во всем полупроводнике вплоть до границы при  $x=0$ . Это справедливо, если сквоз-

ной ток через структуру мал. Тогда (23), (24), (31) и (32) приводят к следующему граничному условию для потенциала  $\psi$ :

$$\psi(x)|_{x=0} = V + V_D, \quad (33)$$

где  $V_D$  — диффузионный потенциал, определяемый формулой (5).

В случае резкого изотипного гетероперехода в точке  $x=a$

$$N(x), \quad \varepsilon(x) = \begin{cases} N_1, & \varepsilon_1 \quad \text{при } x < a, \\ N_2, & \varepsilon_2 \quad \text{при } x > a. \end{cases} \quad (34)$$

Тогда уравнение (27) принимает вид

$$d^2\psi_1/dx^2 = (4\pi e N_1/\varepsilon_1)(1 - e^{-e\psi_1/kT}), \quad x < a, \quad (35)$$

$$d^2\psi_2/dx^2 = (4\pi e N_2/\varepsilon_2)(1 - e^{-e\psi_2/kT}), \quad x > a. \quad (36)$$

Решения  $\psi_1$  и  $\psi_2$  «стыкаются» друг с другом на гетеропереходе следующим образом:

$$\varepsilon_1(d\psi_1/dx)|_{x=a} = \varepsilon_2(d\psi_2/dx)|_{x=a}, \quad (37)$$

$$\psi_2(a) = \psi_1(a) + \Delta\psi. \quad (38)$$

Уравнением (37) выражается непрерывность индукции, а (38) — условие разрыва (6) на гетерогранице, которое для случая узкозонной прослойки имеет вид

$$\Delta\psi = \Delta E_c + (kT/e) \ln(N_2 N_{c1}/N_1 N_{c2}). \quad (39)$$

Мы дадим решения уравнений (35) и (36) с граничными условиями (30), (33), (37) и (38) в приближении истощенного слоя, а также в форме первых интегралов.

#### 4. Решение в приближении истощенного слоя

Результаты решения в этом приближении обсуждались выше в связи с рис. 2 и 3. Отмечалось, что на ВФХ  $t-s$ -структуры существуют три различных режима.

1) *Режим существования квазинейтральной области в узкозонной прослойке.* В этом режиме ОПЗ, примыкающая к металлу, имеет толщину  $W < a$ . Квазинейтральный слой, находящийся при  $W < x < a$ , представляет собой проводник, экранирующий вторую ОПЗ, которая расположена за гетеропереходом в широкозонной толще. Дело в том, что омическое сопротивление этой ОПЗ невелико, поскольку барьер в системе  $\text{Ga}_x\text{Al}_{1-x}\text{As}$  не превышает 0.3 эВ. В этом случае гетеропереход себя никак не проявляет, а система ничем не отличается от обычного диода Шоттки на толстом узкозонном полупроводнике. Тогда применима хорошо известная теория, которая дает обычное выражение для емкости:

$$C = \varepsilon_1 S / 4\pi W, \quad W = \sqrt{\varepsilon_1(V + V_D)/2\pi e N_1}, \quad (40)$$

где  $W$  — толщина приконтактной ОПЗ. Таким образом, мы приходим к формуле (9) для приведенной характеристики  $\chi(V)$ . Граница этого режима достигается, когда  $W=a$ , таким образом, мы получаем формулу (4) для граничного значения  $V_1$ .

2) *Режим моттовского плато.* В этом случае граница ОПЗ достигает гетероперехода. Однако вблизи него внутри узкозонной прослойки существует тонкая область, обогащенная электронами. Эта область имеет толщину порядка дебаевского радиуса и поэтому не описывается приближением истощенного слоя. Проводящая область действует подобно экрану, который электрически соединен с широкозонной толщой. Емкость такой структуры равна величине, даваемой формулой (1), для плоского конденсатора толщиной  $a$ . Она не зависит от напряжения, чем и обусловлено моттовское плато. С ростом внешнего смещения  $V$  обогащенный слой становится все тоньше и при  $V=V_1+\Delta V$  пол-

ностью исчезает. При этом происходит смыкание полностью истощенной прослойки с ОПЗ за гетеропереходом в широкозонной толще и емкость скачкообразно изменяется. Этому соответствует вертикальная ступень на ВФХ.

3) Режим полного истощения узкозонной прослойки. В этом случае мы имеем дело с простой электростатической задачей определения потенциала в системе двух заряженных диэлектриков. Для прослойки

$$V + V_D = a\mathcal{E}_a^{(1)} + V_a + U, \quad (41)$$

где  $U$  — потенциал провала, а  $\mathcal{E}_a^{(1)}$  — поле на гетерогранице. Поле в широкозонной области  $\mathcal{E}_a^{(2)}$  выражается формулой

$$\mathcal{E}_a^{(2)} = \sqrt{(8\pi e/N_2/\epsilon_2)(\Delta\phi + U)}. \quad (42)$$

Это поле связано с  $\mathcal{E}_a^{(1)}$  условием непрерывности индукции (37). Таким образом, мы имеем три уравнения для трех неизвестных —  $U$ ,  $\mathcal{E}_a^{(1)}$ ,  $\mathcal{E}_a^{(2)}$ , решение которых дает выражение (11) для функции  $\chi(V)$ .

## 5. Точное решение

Первый интеграл уравнения (35) находится умножением его на  $d\phi/dx$  и последующим интегрированием:

$$dy_1/dx = \sqrt{2}\kappa_1(y_1 + e^{-y_1} - u - e^{-u} + E_a^2)^{1/2}, \quad (43)$$

где  $\kappa_1$  — обратный дебаевский радиус узкозонной прослойки,

$$y_1(x) = e\phi_1(x)/kT, \quad u = eU/kT, \quad U = \psi_1(a), \quad (44)$$

где  $y_1$  — безразмерный потенциал при  $x < a$ ,  $u$  — безразмерный потенциал провала на гетерогранице. Величина  $E_a$  — константа интегрирования, пропорциональная полю  $\mathcal{E}_a^{(1)}$ , так что

$$(dy_1/dx)_{x=a} = -\sqrt{2}\kappa_1 E_a. \quad (45)$$

Аналогичное интегрирование можно произвести в области  $x > a$ :

$$dy_2/dx = -\sqrt{2}\kappa_2(y_2 + e^{-y_2} - 1)^{1/2}, \quad (46)$$

где

$$y_2(x) = e\phi_2(x)/kT, \quad \kappa_2^2 = 4\pi e^2 N_2/\epsilon_2 kT. \quad (47)$$

Используя условие непрерывности индукции (37) при  $x=a$ , найдем

$$E_a^2 = (\eta + e^{-\eta} - 1)/\alpha \approx (\eta - 1)/\alpha, \quad (48)$$

$$\eta = y_2(a) = e\phi_2(a)/kT. \quad (49)$$

Поскольку  $\eta \gg 1$ , то  $\exp(-\eta)$  в (48) мы пренебрегаем. Формулу (48) удобно переписать в виде

$$E_a^2 = (\beta + u)/\alpha, \quad (50)$$

$\beta = \beta_0 - \ln \alpha$ . Уравнение (43) можно интегрировать еще один раз по толщине прослойки:

$$\int_0^{y_0} dy/\sqrt{f(y)} = \sqrt{2}A, \quad A = \kappa_1 a, \quad (51)$$

где  $f(y)$  определяется формулой (13), а верхний предел интегрирования  $y_0$  будет равен (14). Преобразуем интеграл (51) тождественно

$$\int_0^{y_0} dy/\sqrt{f(y)} = 2[\sqrt{f(y_0)} - \sqrt{f(0)}] + e^{-u} \int_0^{y_0} [e^{-y}/\sqrt{f(y)}] dy. \quad (52)$$

Поскольку  $y_0 \gg 1$ , верхний предел  $y_0$  в правой части (52) заменим на  $\infty$  и положим

$$f(y_0) = v - u - e^{-u} + E_a^2. \quad (53)$$

Тогда

$$\sqrt{2}A = 2[\sqrt{f(y_0)} - E_a] + e^{-u}K(u), \quad (54)$$

где  $K(u)$  определяется формулой (18). Подставляя в (54) выражение (53) и уединяя в левой части  $v$ , получим соотношение (15), связывающее  $v$  и  $u$ .

Еще одно замечание по поводу вычисления интеграла (18) для  $K(u)$ . Функция  $f(y)$ , стоящая под радикалом в интеграле (18), имеет минимум, если значение  $u$  в провале отрицательно;  $u = -v$ . Минимум достигается при значениях

$$y = y_m = v, \quad f_m = v + 1 - e^v + (\beta - v)/\alpha. \quad (55)$$

С ростом  $v$  величина  $f_m$  убывает и при некотором значении  $v = v_0$  обращается в нуль: это значение  $v_0$  определяется уравнением (24).

#### Список литературы

- [1] Константинов О. В., Львова Т. В., Панахов М. М. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 7. С. 1283—1290.
- [2] Lee S. Ch., Pearson G. L. // IEEE Trans. Electron. Dev. 1980. V. ED-27. N 4. P. 844—850.
- [3] Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Панахов М. М. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 4. С. 660—669.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Санкт-Петербург

Получена 20.05.1991  
Принята к печати 17.06.1991